

No.: 201-03-6208-019

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION

6208 Series

1 mm pitch FPC/FFC connector DIP TYPE (Sn-Cu Plated)

京セラ株式会社 KYOCERA Corporation

0	EDN20028	2020/01/31	A. Murata	N. Kitagawa	M. Yoshida
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

- 1. 品名 FPC/FFC Connector
- 2. 形式 1 mm pitch FPC/FFC connector DIP TYPE (Sn-Cu Plated)
- 3. 適用範囲 Scope

本仕様書は 6208 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies Series 6208 1mm pitch FPC/FFC connector.

- 4. 関連規格 Related documentation
 - ・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

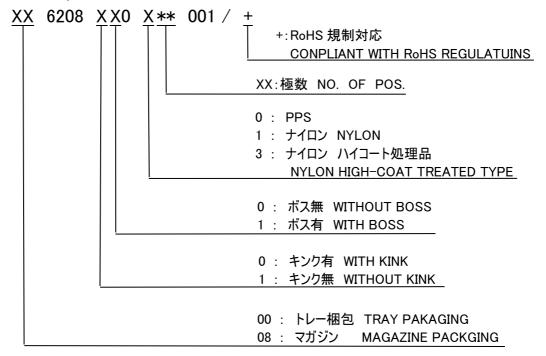
Part 1-100: General-Applicable publications

-JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

- -JIS-C-5402:1992 電子機器用コネクタの試験法 Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.
- 5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material 図面参照 Refer to drawings.
- 6. 製品型番 Part numbering

<DIP TYPE>



仕様 Spec

嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件·方法 Condition	規格 Specification
7.一般	1	定格電流	_	DC 1A/contact
General		Current rating		
	2	定格電圧	_	DC 50V/contact
		Voltage rating		
	3	使用温湿度範囲	_	-40°C ∼ 85°C 95% MAX
		Operation environment		低温に於いて氷結ないこと。
				結露しないこと。
				Ice-free at the low temperature.
				No condensation shall occur.
	4	保存温度範囲	梱包状態にて	-20°C ~ 60°C .
		Storage environment	While packed	低温に於いて氷結ないこと。
				結露しないこと。
				Ice-free at the low temperature.
O 1461-12-04	-	M 5日	口坦	No condensation shall occur. 機能に有害なせば、まれ、まず、亦取
8.機械的	1	外観 Appearance	目視 Visual inspection	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形 等のないこと。
Mechanical		Appearance	Visual inspection	号のないこと。 No rust, contamination, damage
				or deformation effecting on function
	2	スライダー挿入力	25mm/min. / 30 times	初回 Initial 3.92 N MAX./pin
	_	Slider insertion force	Zonini, min. 7 Go cimos	30 回後 30 times 3.34 N MAX./pin
	3	スライダー抜去力	25mm/min. / 30 times	初回 Initial
	ľ	Slider separation force	Zonini/ min. / Go cimes	0.22∼1.76 N /pin
		onder coparación force		30 回後 30 times
				0.22∼1.76 N /pin
	4	コンタクト保持力	25mm/min.	4.9 N MIN.
		Contact retention force		
	5	挿抜耐久性	無通電状態で	外観 Appearance
		Durability	挿抜速さ:10 回/分	素地の露出がないこと。
			挿抜回数∶30 回	Conductor shall not be exposed.
			without Current applied	接触抵抗 Contact resistance
			10 times/min., 30 times	60m Ω MAX.
	6	FPC/FFC 保持力	25mm/min. / 30 times	FPC 保持力 FPC retention force
		FPC/FFC retention force		初回 Initial 0.97 N MIN/PIN
				30 回後 30 times 0.58 N MIN/PIN
				FFC 保持力 FFC separation force
				初 回 Initial 0.97 N MIN./PIN 30 回後 30 times 0.58 N MIN./PIN
	7	拒新	100,550,1047/2:-	
	7	振動 Vibration	10∼55∼10Hz/min. ∕1.5mm (peak to peak)	瞬断 Discontinuity 1 μ s MAX.
		vibiation	/ DC 100mA	「μs MAA. 外観 Appearance
			(2h per direction; XYZ, 6h in total)	機械的破損、部品のゆるみクラック
			IEC 60068-2-6:1995	等ないこと。
			JIS C 60068-2-6:1999	No damage, loose part or crack.
				接触抵抗 Contact Resistance
				60mΩ MAX.

6208 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-6208-019

	9	衝撃 Shock はんだ付性 Solder ability 《Lead-free solder》 『Sn-3Ag-0.5Cu』 ※取り扱い注意事項 7 参照 Refer to precaution 7	50G / 11ms /DC 100mA (3times per direction; XYZ) IEC 60068-2-27:1972 JIS C 60068-2-27:1995 245±3°C /3 _1° sec. immersion IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996	瞬断 Discontinuity 1 μ s MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック等ないこと。 No damage, loose part or crack 浸漬部にはんだが 95%以上 More than 95% of immersed area shall be covered with solder.
	10	はんだ耐熱性 Resistance to solder heat 《Lead-free solder》 『Sn-3Ag-0.5Cu』 ※取り扱い注意事項 7 参照 Refer to precaution 7	1)ディップの場合 適合最小厚基板にて On the thinnest applicable board 260±5℃/ 5±1s. IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996 2)手はんだの場合 はんだごて温度: 380±10℃ 時間: 3 *1 s. 但し、コンタクトに異常加圧のないこと Excessive pressure shall not be applied to the terminals	端子ガタ、変形等ないこと。 There shall be no damage on appearance. Electrical characteristics and mechanical characteristics shall be satisfied.
9.電気的 Electrical	1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC 500V、 1min. (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992	フラッシュオーバー、スパークオーバー及び絶縁破壊ないこと。 No Flashover, spark over dielectric breakdown
	2	絶縁抵抗 Insulation resistance	DC 500V、 1min. JIS C 5402 (5.2):1992	初期 Initial :1000MΩ MIN. 試験後 After test :100MΩ MIN.
	3	ローレベル接触抵抗 Low level contact resistance	四端子法にて Four prove method JIS C 5402 (5.3):1992	30mΩ MAX.
	4	温度上昇 Temperature rise	嵌合状態でコンタクトを直列に 結線 Under mating condition, all contacts shall be connected serially. JIS C 5402 (5.10):1992	定格電流にて 30K MAX. at the Current rating
10.耐環境 Environment	1	硫化水素 H₂S	40±2°C / 75% / 3±1ppm / 240h IEC 60512-11-14:1996	接触抵抗 Contact resistance 60mΩ MAX. 外観 Appearance 著しい腐食が生じないこと。 No evident corrosion.

6208 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-6208-019

2	塩水噴霧	5±1weight%/35±2°C		2°C	外観 Appearance
_	Salt mist	✓48±4h			著しい腐食が生じないこと。
	Sait innoc	IEC 60068-2-11:1981		B1	No evident corrosion.
		JIS C 60068-2-11:1989			
3	温度サイクル	10 cycles		-	接触抵抗 Contact resistance
	Temperature cycling	_	ied) IEC 60068-	-2-14:1984、	60mΩ MAX.
	, , ,	-33:1971			外観 Appearance
		JIS C 0025:1988			異常がないこと。
		段階	温度(℃)	時間(分)	Without distinct damage.
		Step	Temperature	Time(min.)	
		1	-55±3	60	
		2	$25\pm\frac{10}{5}$	5 MAX.	
		3	85±2	60	
		4	$25\pm\frac{10}{5}$	5 MAX.	
4	湿度	40±2°C / 90∼95% / 96h		% / 96h	絶縁抵抗 Insulation resistance
	Moisture resistance	IEC 60068-2-3:1969)	100MΩ MIN.
		JIS C 60068-2-3:1987		87	接触抵抗 Contact resistance
					60mΩ MAX.
					耐電圧
					Dielectric withstanding voltage
					フラッシュオーバー、スパークオーバー
					及び絶縁破壊等がないこと。
					No flashover, spark over nor Dielectric breakdown.
5	高温加速(寿命)	85±2°C ∕ 96h			接触抵抗 Contact resistance
	同価加及(分明) High temperature(Life)	85±2 C / 96n IEC 60068-2-2:1974		!	60mΩ MAX.
	Tigit comporataro(Eno)	JIS C 60068-2-2:1995			00.11.12 1417 U.S.
6	耐寒性 Cold resistance	-25±3°C ∕ 96h			接触抵抗 Contact resistance
		IEC 60068-2-1:1990)	60mΩ MAX.
		JIS C 60068-2-1:1995		95	
7	耐アンモニア	28%のアンモニア水 ammonia water		nmonia water	接触抵抗 Contact resistance
	NH₃ resistance	✓ 25±2°C ✓ 40min.		in.	60mΩ MAX.

取り扱い注意事項 Precautions

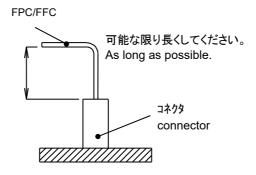
1 FPC/FFC の屈曲について Flexion of FPC/FFC

FPC/FFC の屈曲によりコネクタ接点部に過剰な負荷がかからないようにご注意願います。 尚、FPC/FFC をコネクタのカード挿入口近くで繰り返し屈曲させ使用する場合は、ご相談ください。 条件によっては弊社にて評価確認を行います。

Pay attention not to apply an excess load to contacts of the connector because of the flexion of FPC/FFC.

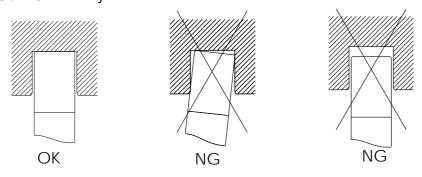
Please contact us when your FPC/FFC have to be bent repeatedly near the opening for card insertion.

Depending on conditions, evaluation and verification shall be conducted by us.



2 FPC/FFC の挿入について FPC/FFC insertion and separation

FPC/FFC はカードスロット底面に当てられるまで垂直に挿入して下さい。 Insert the FPC /FFC vertically until it hits to the slot end.

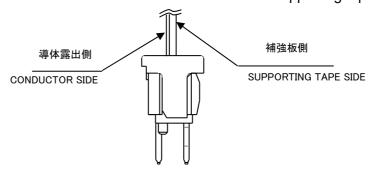


検査工程等で FPC/FFC の挿抜を行う際は、最終組み込み用 FPC/FFC よりも薄い FPC/FFC を使用願います。

For the FPC/FFC insertion and separation in the inspection process, please use thinner FPC/FFC than those for final assembling.

3 FPC/FFC の方向性 Direction of FPC/FFC

図のように導体露出面を左にし、補強板が右側になるように装着して下さい。 FPC/FFC shall be inserted as shown below with conductor side left and supporting tape side right.



4 スライダー操作 Slider operation

コネクタの破損防止の為、スライダー操作は基板に半田付け後行うようにして下さい。 After soldering, a slider shall be operated to prevent damage to a connector.

5 実装について Mounting

本製品は低背、省面積化を実現する為、インシュレータが非常に薄肉になっております。

従いまして、FPC 基板へのマウント等実装条件につきましては弊社と打合わせの上、確認して頂きますようお願い致します。

また、FPC 実装の場合 FPC のたわみにより半田クラックなどが発生する可能性があります。

この為、実装部にはできるだけ厚い(少なくとも 0.3 mm 以上)補強板を貼り付けることを推奨します。

リフロー加熱によりインシュレータ外表部にふくれが発生する場合がありますが、FPC/FFC の挿入及びコンタクトの可動を妨げるものではなく、実使用上問題はありません。

Thin molding insulators realize the low-profile and small space character of this product.

Mounting conditions on FPC boards, therefore, need to be consulted with us and confirmed.

When an FPC board is connected, deflection in bending the FPC board may cause a solder crack.

In order to prevent it, it is suggested to attach a reinforcing plate that has 0.3 mm or more in thickness to the connecting area on the FPC board.

Although blisters may be formed due to the reflow heat, it will not interfere with the movability of contacts, so there is no practical problem.

6 活線挿抜について Hot Swap

本製品に電流を流した状態での挿抜は、なさらないよう御願い致します。

Insertion and separation under live current shall not be done.

7 はんだについて Solder

本製品は、鉛フリーはんだ Sn-3Ag-0.5Cu の使用を推奨しております。推奨はんだ以外の使用については御相談下さい。

Lead-free solder Sn-3Ag-Cu is recommended to be used with this connector.

Please consult us if your solder is different from the ones of our recommendation.

8 その他 Other

8-1.本製品の樹脂部に黒点・変色等が確認される場合がありますが製品性能には影響はございません。 Although there may be some small dark spots or discoloration on this product, the product performance will not be affected.

8-2.樹脂部のウエルド部に線が確認される場合がありますが、製品仕様書、取扱い説明書の範囲での使用に於いて、性能に影響はございません。

Although a line may appear on the welded part on the housing, it does not affect on connector performance as long as the connector is used according to the specifications and the instruction manual.

8-3.リフロー後、半田付け部に変色が見られることがありますが、製品性能に影響はございません。 Although there might be some discoloration seen on the soldering tail after reflow, this will not Influence the product's performance.

8-4.コンタクト露出部等に金めっきが付着している場合がありますが、製品性能に影響はございません。 Although there are some case that Au plating is painted the spot of contact as you can see there is nothing quality of the product

特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

(1)本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、 本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、 貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2)本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。 If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.
- (3)以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

- 1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の 条件が加わった事が証明された場合。
 - If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.
- 2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛

Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.